

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年1月2日(02.01.2020)



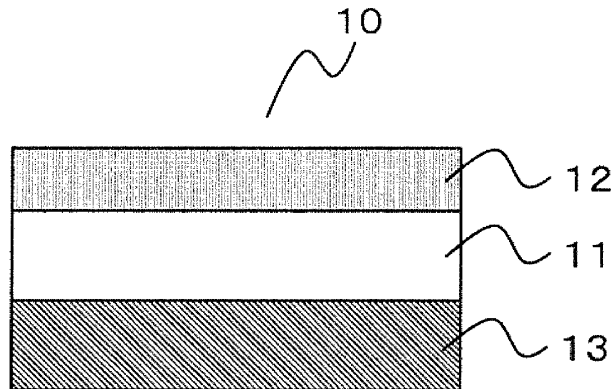
(10) 国際公開番号

WO 2020/003920 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 7/29 (2018.01) *H01L 21/301* (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
C09J 201/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/022165
- (22) 国際出願日: 2019年6月4日(04.06.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2018-121129 2018年6月26日(26.06.2018) JP
- (71) 出願人: リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町2-3-23 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 愛澤 和人 (AIZAWA, Kazuto); 〒1730001 東京都板橋区本町2-3-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 前田 淳(MAEDA, Jun); 〒1730001 東京都板橋区本町2-3-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 前田・鈴木国際特許業務法人 (MAEDA & SUZUKI); 〒1010003 東京都千代田区一ツ橋2丁目5番5号 岩波書店一ツ橋ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: ADHESIVE TAPE FOR SEMICONDUCTOR PROCESSING AND METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体加工用粘着テープおよび半導体装置の製造方法



(57) Abstract: [Problem] To provide an adhesive tape for semiconductor processing, which is capable of suppressing cracks of a chip even if used in DBG or LDBG. [Solution] An adhesive tape for semiconductor processing, which comprises a base material, a buffer layer that is provided on at least one surface side of the base material, and an adhesive layer that is provided on the other surface side of the base material. This adhesive tape is configured such that: the buffer layer has a Young's modulus of 10-400 MPa at 23°C and a rupture energy of 1-9 MJ/m³; and the Young's modulus of the base material at 23°C is higher than the above-mentioned Young's modulus of the buffer layer.

[続葉有]



WO 2020/003920 A1

SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 【課題】DBGまたはLDBGに用いても、チップのクラックを抑制できる半導体加工用粘着テープを提供すること。【解決手段】基材と、当該基材の少なくとも一方の面側に設けられた緩衝層と、当該基材の他方の面側に設けられた粘着剤層とを有する粘着テープであって、前記緩衝層の23℃におけるヤング率が10～400MPaであり、破断エネルギーが1～9MJ/m³であって、前記基材の23℃におけるヤング率が前記緩衝層のヤング率よりも大きい、半導体加工用粘着テープ。